

HB

中华人民共和国航空工业标准

HB 7091—94

机载设备标准电子模块的设计要求

1994—10—31 发布

1995—01—01 实施

中国航空工业总公司 批准

目 次

1 主题内容与适用范围	(1)
2 引用标准	(1)
3 术语	(1)
4 分类和型式	(2)
5 技术要求	(2)
附录 A B型模块的设计要求(补充件)	(16)
附录 B C型、D型、E型模块的设计要求(补充件)	(22)
附录 C F型模块的设计要求(补充件)	(30)
附录 D 标准电子模块的元器件降额、热性能和失效率预计	(35)

1 主题内容与适用范围

本标准规定了机载设备标准电子模块的结构(包括机械和电气)、环境、标记和可靠性等设计要求。

本标准适用于军用机载设备标准电子模块的设计。

2 引用标准

GJB 33	半导体器件总规范
GJB/Z 299A	电子设备可靠性预计
GJB 362	印制板通用规范
GJB 597	微电路总规范
GJB 1422	标准电子模块总规范
GJB/Z 35	元器件降额准则
HB/Z 5071	化学镀镍工艺
HB/Z 5076	铝及铝合金阳极氧化工艺
HB/Z 5079	钢铁零件化学氧化工艺
HB 7092	机载设备标准电子模块的采用要求

3 术语

3.1 标准电子模块(以下简称模块)

按 HB 7092 规定程序设计的,主要由电子元器件组成具有规定功能的插入式组装单元,由这些组装单元可以组合成各种复杂的军用电子设备。

3.2 标志代码

由字母组成的标志符号,用于标识定位销的类型和角度位置。

3.3 α 端

靠近模块插针编号最小的那一端。

3.4 β 端

远离模块插针编号最小的那一端。

3.5 元器件临界温度(CCT)

模块在其最高温度等级下工作时,模块内任何元器件所允许的最高结温。

3.6 元器件瞬态临界温度(TCCT)